



アルカリ現像型PKG用DFSR AUS SR3 (薄型、コアレスサブストレータ対応)

Photo-imageable Solder Resist for Ultra Thin/ Coreless application

特徴 Features

- 高弾性率 / 高剛性 (High Modulus & Stiffness)
- 低 CTE / 高 Tg (Low CTE / High Tg)
- 高強度 (High Strength)
- 優れた解像性 (High Resolution)
- ドライフィルムタイプ (Dry film type)

特性 Properties

ガラス移転点 Tg *TMA method	150-160 °C
線膨張係数 CTE($\alpha 1$)	15-20 ppm
弾性率 modulus *DMA method	14.0-15.0 GPa
破壊強度 Tensile strength	90-100 MPa
破壊伸び率 Elongation	2.0-3.0 %
HAST耐性 (130°C/85%RH, 5V,L/S=12/13)	300h Pass

